

 '05年3月期 決算説明会補足説明資料  
Year ended March 31, 2005  
Analyst Guide

株式会社 フェローテック (証券コード:店頭 6890)  
Ferrotec Corporation Code-No.6890(JASDAQ)

2005年6月1日  
Jun 01, 2005

目次 Contents

	ページ	Page
1. 連結子会社及び関連会社一覧 Consolidated Subsidiaries & Company Accounted for by the Equity Method	1, 2	
2. 連結貸借対照表(資産の部) Consolidated Balance Sheet (Assets)	3	
3. 連結貸借対照表(負債・資本の部) Consolidated Balance Sheet (Liabilities, Minority interests and Shareholders' equity)	4	
4. 連結損益計算書 Consolidated Statements of Income	5	
5. 連結セグメント別売上高 Segment Information (Consolidated)	6	
6. 下期計画と実績との差異 Review in the second half	7	
7. 連結損益計算書(計画) Consolidated Statements of Income (Estimated)	8	
8. 連結キャッシュフロー Consolidated Statements of Cash Flows	9	
9. 主要製品の売上推移 Proceeds change of a main product	10	

本資料は、当社グループの評価を行うための情報提供を目的としたものです。  
本資料に記載された数値等は資料作成時点のものであり、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。  
本資料に基づいた投資等の結果に対する責任は負いかねますのでご了承ください。

This report is provided solely for the information of professional analysts who are expected to make their own evaluation of the consolidated Subsidiaries.

We don't guarantee the accuracy or completeness of information herein.

Unless otherwise stated estimates or forecasts are solely those of our company and subject to change without notice.

We accept no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report.

This report isn't intended for the use of private investors.

## 1. 連結子会社及び関連会社一覧 Consolidated Subsidiaries & Company Accounted for by the Equity Method

### 連結子会社13社 Consolidated Subsidiaries(13)

子会社 Subsidiary	所在地 Country	主要製品 Major Products	資本金 Capital Stock	出資比率 Equity Ownership
杭州大和熱磁電子有限公司 HANGZOU DAHE THERMO-MAGNETICS CO., LTD.	中国 China	コンピュータシール、サーモモジュール、CMS Computer Seals, Thermo-electric Modules, CMS	2,545百万円 2,545million yen	99.9%
上海申和熱磁電子有限公司 SHANGHAI SHENHE THERMO-MAGNETICS CO., LTD.	中国 China	磁性流体、サーモモジュール、CMS Ferro Fluid, Thermo-electric Modules, CMS	2,079百万円 2,079million yen	100.0%
杭州日磁科技工業園産業開発有限公司 HANGZHOU NIPPON-MAGNETICS SCIENCE INDUSTRY PARK DEVELOPMENT CO.,LTD.	中国 China	その他 Others	650百万円 650million yen	100.0%
上海漢虹精密機械有限公司 SHANGHAI HANHONG PRECISION MACHINERY CO.,LTD	中国 China	工作機械 Machine tool	2,820千ドル \$ 2,820 thousand	100.0%
FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD.	シンガポール Singapore	コンピュータシール、石英 Computer Seals, Quartz	1,300千シンガポールドル 1,300 thousand Singapore dollar	100.0%
Ferrotec (USA) Corporation	米国 USA	真空シール、サーモモジュール Vacuum Feedthroughs, Thermo-electric Modules	24,966千ドル \$ 24,966 thousand	100.0%
Ferrotec Investments,LLC	米国 USA	その他 Others	350千ドル \$350 thousand	100.0%
Ferrotec GmbH	ドイツ Germany	その他 Others	511千ユーロ 511thousand euro	100.0%
(株)フェローテック精密 Ferrotec Precision Corporation	日本 Japan	真空シール、その他 Vacuum Feedthroughs, Others	225百万円 225million yen	100.0%
(株)フェローテッククオーツ Ferrotec Quartz Corporation	日本 Japan	石英 Quartz	475百万円 475million yen	100.0%
(株)フェローテックシリコン Ferrotec Silicon Corporation	日本 Japan	シリコンインゴット、シリコンウエハ Silicon products, CMS	181百万円 181million yen	100.0%
アリオンテック(株) ALIONTEK CORPORATION	日本 Japan	石英 Quartz	93百万円 93million yen	44.0%
(株)テクノソーリングシステム Techono Tooling Systems Co., Ltd.	日本 Japan	切削加工用工具 Precision tool	50百万円 50million yen	69.0%

\* アリオンテック(株)は商法上の子会社ではないが、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」に定める連結子会社。

持分法適用会社2社 Company Accounted for by the Equity method(2)

持分法適用会社 Company Accounted for by the Equity Method				
ダイヤセルテック(株) DIACELLTEC CORP.	日本 Japan	リチウムイオン2次電池 Lithium-Ion Rechargeable Battery	320百万円 320million yen	18.4%
杭州菱日科技有限公司 (ダイヤセルテックの100%子会社) HANGZOU LINGRI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.	中国 China	リチウムイオン2次電池 Lithium-Ion Rechargeable Battery	350百万円 350million yen	18.4% (間接所有)

## 2. 連結貸借対照表(資産の部) Consolidated Balance Sheet (Assets)

(単位 百万円、%)

科目	Title of account	04/3		05/3		前期比		コメント
		金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	増減率 YOY	
<b>流動資産</b>	<b>Current assets</b>	<b>11,976</b>	<b>41.4</b>	<b>12,599</b>	<b>41.9</b>	<b>623</b>	<b>5.2</b>	1. 流動資産
現金及び預金	Cash and Deposits	3,123	10.8	3,188	10.6	65	2.1	(1)受取手形・売掛金増加要因:売上高の増加による
受取手形・売掛金	Notes and account receivable	4,298	14.9	5,065	16.9	767	17.8	2. 主なたな卸資産:真空シール 513 石英755
たな卸資産	Inventories	2,791	9.6	2,922	9.7	131	4.7	シリコンウエーハ404(いずれも単位:百万円)
繰延税金資産	Deferred tax assets	113	0.4	133	0.4	20	17.7	
その他	Other assets	1,789	6.2	1,442	4.8	△ 347	△ 19.4	(3)その他の減少要因:ダイヤセルテック(DCT)に対する短期
貸倒引当金	Allowance for doubtful receivables	△ 140	△ 0.5	△ 153	△ 0.5	△ 12	9.3	貸付金787百万円を長期貸付金へ振替
<b>固定資産</b>	<b>Fixed assets</b>	<b>16,958</b>	<b>58.6</b>	<b>17,441</b>	<b>58.1</b>	<b>483</b>	<b>2.8</b>	4. 有形固定資産
<b>有形固定資産</b>	<b>Tangible fixed assets</b>	<b>10,622</b>	<b>36.7</b>	<b>11,190</b>	<b>37.1</b>	<b>568</b>	<b>5.3</b>	(1)建物・構築物:主に機械装置・運搬具:シリコンウエーハ加工設備
建物・構築物	Building and Structures	3,234	11.2	3,047	10.1	△ 187	△ 5.8	
機械装置・運搬具	Machinery and Equipment	3,445	11.9	3,608	12.0	162	4.7	(2)土地:換算レートの影響で減少
工具器具備品	Tools, furniture and fixtures	963	3.3	955	3.2	△ 8	△ 0.8	(3)建設仮勘定:杭州新第3工場(5月竣工)
土地	land	2,602	9.0	2,552	8.5	△ 49	△ 1.9	
建設仮勘定	Construction in progress	375	1.3	1,027	3.4	651	173.9	5. 無形固定資産
<b>無形固定資産</b>	<b>Intangible fixed assets</b>	<b>2,644</b>	<b>9.1</b>	<b>2,642</b>	<b>8.8</b>	<b>△ 1</b>	<b>△ 0.1</b>	(1)営業権:Ferrotec (USA) Corporationによるアドバンスト・フ
営業権	Goodwill	1,715	5.9	1,943	6.5	227	13.3	ルイド・システム(英国)の真空シール営業権譲受
その他	Other assets	928	3.2	699	2.3	△ 229	△ 24.7	(2)その他:フェローテックシリコンの連調一括償却188百万円
<b>投資その他の資産</b>	<b>Investments and other assets</b>	<b>3,692</b>	<b>12.8</b>	<b>3,608</b>	<b>12.0</b>	<b>△ 83</b>	<b>△ 2.3</b>	6. 投資その他の資産
投資有価証券	Investment securities	1,643	5.7	1,558	5.2	△ 85	△ 5.2	(1)投資有価証券:売却による減少
長期貸付金	Long-term loans	48	0.2	817	2.7	768	1,602.1	(2)長期貸付金:DCTに対する貸付金787を短期貸付金から振
繰延税金資産	Deferred tax assets	381	1.3	27	0.1	△ 354	△ 92.9	替
その他	Other assets	1,641	5.7	1,366	4.5	△ 274	△ 16.8	(3)繰延税金資産:税務上の繰越欠損金の減少のため
貸倒引当金	Allowance for doubtful receivables	△ 22	△ 0.1	△ 160	△ 0.5	△ 138	627.3	
<b>資産合計</b>	<b>Total assets</b>	<b>28,934</b>	<b>100.0</b>	<b>30,041</b>	<b>100.0</b>	<b>1,107</b>	<b>3.8</b>	

参考. 換算レート表

	03/3期		03/9期		04/3期		04/9期		05/3期	
	02/12	03/3	03/6	03/9	03/12	04/3	04/6	04/9	04/12	05/3
US\$	119.90	120.20	119.80	111.25	107.13	105.69	108.43	111.05	104.21	107.39
Singapore \$	69.16	68.01	68.12	64.37	62.94	62.91	63.21	65.69	63.55	65.19
RMB	14.49	14.51	14.43	13.45	12.94	12.75	13.09	13.41	12.49	12.94

各期の左側は、子会社の換算レート(子会社は12月決算の為)です。

### 3. 連結貸借対照表(負債・資本の部)

Consolidated Balance Sheet (Liabilities, Minority interests and Shareholders' equity)

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	04/3		05/3		前期比		コメント
		金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	前期比 YOY	
<b>流動負債</b>	<b>Current liabilities</b>	<b>9,253</b>	<b>32.0</b>	<b>9,548</b>	<b>31.8</b>	<b>294</b>	<b>3.2</b>	1. 有利子負債: 短期借入金+1年内長期借入金 5,312(同 5,598) 長期借入金+社債等 5,413(同 6,923) 合計 10,725(同 12,521) *カッコ内は04/3期
支払手形及び買掛金	Notes and accounts payables	1,889	6.5	1,840	6.1	△ 48	△ 2.6	
短期借入金	Short-term borrowings	3,197	11.0	3,093	10.3	△ 103	△ 3.3	
1年内返済予定長借入	Current portion of long-term borr.	2,401	8.3	2,219	7.4	△ 182	△ 7.6	
未払法人税等	Accrued corporation taxes	52	0.2	166	0.6	113	219.2	
その他	Other current liabilities	1,712	5.9	2,229	7.4	517	30.2	
<b>固定負債</b>	<b>Long-term liabilities</b>	<b>7,101</b>	<b>24.5</b>	<b>5,620</b>	<b>18.7</b>	<b>△ 1,480</b>	<b>△ 20.9</b>	2. スイス・フラン建転換社債型新株予約権付社債(CB): 転換による減少
新株予約権付社債	Bonds with warrants	1,870	6.5	1,776	5.9	△ 93	-	
長期借入金	Long-term borrowings	5,053	17.5	3,637	12.1	△ 1,415	△ 28.0	
その他	Other long-term liabilities	177	0.6	205	0.7	28	15.8	
<b>負債合計</b>	<b>Total Liabilities</b>	<b>16,355</b>	<b>56.5</b>	<b>15,168</b>	<b>50.5</b>	<b>△ 1,186</b>	<b>△ 7.3</b>	
<b>少数株主持分</b>	<b>Minority interests</b>	<b>24</b>	<b>0.1</b>	<b>83</b>	<b>0.3</b>	<b>58</b>	<b>245.8</b>	
<b>資本金</b>	<b>Common stock</b>	<b>5,824</b>	<b>20.1</b>	<b>6,910</b>	<b>23.0</b>	<b>1,085</b>	<b>18.6</b>	} 3. CB転換及び公募増資による増加
<b>資本剰余金</b>	<b>Capital surplus</b>	<b>6,700</b>	<b>23.2</b>	<b>7,784</b>	<b>25.9</b>	<b>1,083</b>	<b>16.2</b>	
<b>利益剰余金</b>	<b>Profit surplus</b>	<b>293</b>	<b>1.0</b>	<b>762</b>	<b>2.5</b>	<b>468</b>	<b>160.1</b>	4. 公募増資(2005年3月): ネット調達額 2,049百万円 発行新株式数 2,800千株 発行価格 786円 2,800千株にはオーバーアロットメントを含みます。
その他有価証券評価差額金	Securities valuation adjust.	210	0.7	153	0.5	△ 56	△ 27.1	
為替換算調整勘定	Cumulative translation adjust.	△ 313	△ 1.1	△ 661	△ 2.2	△ 347	-	
自己株式	Treasury stock-at cost	△ 160	△ 0.6	△ 160	△ 0.5	△ 0	-	
<b>資本合計</b>	<b>Total shareholders' equity</b>	<b>12,555</b>	<b>43.4</b>	<b>14,789</b>	<b>49.2</b>	<b>2,234</b>	<b>17.8</b>	1株当たり株主資本(BPS) 742.57円
<b>負債、少数株主持分及び資本合計</b>		<b>28,934</b>	<b>100.0</b>	<b>30,041</b>	<b>100.0</b>	<b>1,106</b>	<b>3.8</b>	総資産回転率(総資産は期末ベース) 04/3期 0.51回 05/3期 0.70回
Total liabilities, Minority interests and Shareholders' equity								

### \* 事業セグメントと製品区分 Operations in different industries & Products

装置関連	Production device relation	電子デバイス	Electron device	受託生産	CMS
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	コンピュータシール	Computer Seals	受託生産	Contract Manufacturing Service
石英製品	Quartz	サーモモジュール	Thermo-electric Modules		
シリコン製品	Silicon products	磁性流体・その他	Ferro Fluid & Others		
EB-ガン・その他	EB-Gun & Others	基板実装	Surface mount chips		

#### 4. 連結損益計算書 Consolidated Statements of Income

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	04/3		05/3		前期比 YOY	コメント
		金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	構成比 Share		
売上高	Net Sales	15,000	100.0	21,105	100.0	40.7	<p>1. 事業セグメント別の状況</p> <p>(1) 装置関連: 真空シールは半導体向けの回復に加えFPD向けも堅調、中国移管で取引先が拡大した石英製品も伸長</p> <p>(2) 電子デバイス: 自動車温調シート向け、半導体製造装置向けにサーモモジュールは伸長。コンピュータシールは製品ライフサイクルが終末期を迎えつつあるものの、計画超過で着地</p> <p>(3) CMS: 本格稼動したシリコンウエーハ加工をけん引役に大幅増収。中国ローカルマーケット向けに工作機械が伸長、部品洗浄も顧客開拓が進展</p> <p>2. 売上総利益: 増収効果により増加。CMSの構成比が上昇したが、同事業の収益性改善で粗利率低下は軽微</p> <p>3. 販管費増加要因(但し、対売上比は4.2ポイント改善)</p> <p>(1) アリオンテック連結により増加</p> <p>(2) 杭州大和: 主要製品の増収により増加</p> <p>(3) 上海申和: CMS事業の増収により増加</p> <p>4. 営業外損益</p> <p>為替が比較的安定して推移し、多額な為替損益は発生しなかった</p> <p>5. 特別損益の主な内容</p> <p>特別利益: 固定資産売却益 48百万円 投資有価証券売却益 95百万円</p> <p>特別損失: 固定資産処分損 89百万円 フェローテックシリコンの連調一括償却188百万円</p>
売上原価	Cost of sales	10,218	68.1	14,423	68.3	41.2	
売上総利益	Gross profit	4,781	31.9	6,682	31.7	39.8	
販管費	SG&A expense	4,166	27.8	4,920	23.3	18.1	
営業利益(A)	Operating Income	615	4.1	1,762	8.3	185.0	
営業外収益	Other income	179	1.2	244	1.2	36.3	
受取利息・配当金	Interest&Dividend Income	50	0.3	44	0.2	△ 12.0	
受取手数料	Receipt fee	13	0.1	40	0.2	207.7	
賃貸収入	Lease income	34	0.2	40	0.2	17.6	
為替差益	Foreign exchange gain	-	-	15	0.1	-	
その他	Other income	80	0.5	103	0.5	28.8	
営業外費用	Other expense	972	6.6	550	2.6	△ 43.4	
支払利息	Interest expense	292	1.9	303	1.4	3.8	
たな卸資産処分損	Inventory losses	-	-	84	-	-	
持分法投資損失	Equity in loss of investees	128	0.9	58	0.3	△ 54.7	
為替差損	Foreign exchange loss	317	2.1	-	-	-	
その他	Other expense	232	1.5	103	0.5	△ 55.6	
経常利益	Recurring income	△ 177	△ 1.2	1,456	6.9	-	
特別利益	Extraordinary gain	103	0.7	212	1.0	105.8	
特別損失	Extraordinary loss	484	3.2	458	2.2	△ 5.4	
税引前利益	Income before income taxes	△ 559	△ 3.7	1,210	5.7	-	
法人税等	Income tax (current)	24	0.2	182	0.9	658.3	
同 調整額	Income tax (deferred)	61	0.4	350	1.7	473.8	
少数株主利益	Minority interest	0	0.0	43	0.2	-	
当期利益	Net income	△ 645	△ 4.3	633	3.0	-	
設備投資	Capital expenditures	2,136		2,073			主に中国子会社CMS関連投資(上海 667百万円 杭州 1,166百万円)
減価償却費(B)	Depreciation & amortization	1,180		1,359			
研究開発費	R&D expenses	188		109			
EBITDA(A+B)	Cash flows	1,795		3,121			
1株利益(円)	EPS(yen)	△ 37.80		35.15			
1株EBITDA(円)	EBIDAPS(yen)	105.52		156.70			
1株配当金(単独、円)	DPS(yen)	8.0		8.0			
期末従業員数(人)	Number of employees	2,800		3,323			

## 5. 連結セグメント別売上高 Segment Information (Consolidated)

### 事業別 Operations in different industries

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

決算期 Accounting Period	05/3	05/3上	05/3下	05/3通期	構成比	前期比	06/3上	前年同期比	06/3下	前年同期比	06/3通期	構成比	前期比
製品 Product type	Budget	1st Half	2nd Half	Year Ended	Share	YOY	1st Half	YOY	2nd Half	YOY	Year Ended	Share	YOY
真空シール・部品 Vacuum Feedthroughs	3,900	2,052	2,162	4,214	20.0	35.7	1,990	△ 3.0	2,210	2.2	4,200	18.8	△ 0.3
石英製品 Quartz	3,919	2,094	2,206	4,300	20.4	61.8	1,767	△ 15.6	2,205	△ 0.0	3,972	17.7	△ 7.6
シリコン製品 Silicon products	998	497	603	1,100	5.2	34.0	659	32.6	612	1.5	1,271	5.7	15.5
EB-ガン・その他 EB-Gun&Others	1,419	696	893	1,589	7.5	18.8	771	10.8	1,036	16.0	1,807	8.1	13.7
<b>装置関連 Production device Related</b>	<b>10,236</b>	<b>5,339</b>	<b>5,864</b>	<b>11,203</b>	<b>53.1</b>	<b>41.4</b>	<b>5,187</b>	<b>△ 2.8</b>	<b>6,063</b>	<b>3.4</b>	<b>11,250</b>	<b>50.2</b>	<b>0.4</b>
コンピュータシール Computer Seals	902	697	315	1,012	4.8	△ 25.8	91	△ 86.9	67	△ 78.7	158	0.7	△ 84.4
サーモモジュール Thermo-electric Modules	1,998	1,128	926	2,054	9.7	30.2	933	△ 17.3	1,289	39.2	2,222	9.9	8.2
磁性流体・その他 Ferro Fluid&Others	544	290	222	512	2.4	△ 24.7	270	△ 6.9	252	13.5	522	2.3	2.0
<b>電子デバイス Electric devices</b>	<b>3,444</b>	<b>2,116</b>	<b>1,461</b>	<b>3,578</b>	<b>17.0</b>	<b>△ 1.2</b>	<b>1,294</b>	<b>△ 38.8</b>	<b>1,608</b>	<b>10.1</b>	<b>2,902</b>	<b>13.0</b>	<b>△ 18.9</b>
<b>受託生産 CMS</b>	<b>7,120</b>	<b>3,328</b>	<b>2,997</b>	<b>6,325</b>	<b>30.0</b>	<b>82.9</b>	<b>3,619</b>	<b>8.7</b>	<b>4,629</b>	<b>54.5</b>	<b>8,248</b>	<b>36.8</b>	<b>30.4</b>
<b>売上高合計 Total Sales</b>	<b>20,800</b>	<b>10,783</b>	<b>10,322</b>	<b>21,105</b>	<b>100.0</b>	<b>40.7</b>	<b>10,100</b>	<b>△ 6.3</b>	<b>12,300</b>	<b>19.2</b>	<b>22,400</b>	<b>100.0</b>	<b>6.1</b>

装置関連 Equipment related	-	692	682	1,374	78.0	267.4							
電子デバイス Electronic devices	-	316	△ 71	245	13.9	△ 48.9							
受託生産 CMS	-	75	106	181	10.3	-							
全社 All	-	△ 21	△ 18	△ 37	△ 2.1	-							
<b>営業利益合計 Operating Income</b>	<b>1,650</b>	<b>1,063</b>	<b>699</b>	<b>1,762</b>	<b>100.0</b>	<b>185.0</b>	<b>345</b>	<b>△ 67.5</b>	<b>1,455</b>	<b>108.2</b>	<b>1,800</b>	<b>-</b>	<b>2.2</b>

※ご参考 営業利益

## 6. 下期計画と実績との差異 Review in the second half

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	05/3下期計画(A)		05/3下期実績(B)			コメント
		Original plan		Achievement			
		金額	前年同期比	金額	前年同期比	計画比	
		Mil.Yen	YOY	Mil.Yen	YOY	B/A	
売上高	Net Sales	10,017	22.5	10,322	26.2	3.0	1. 連結売上高: 装置関連を中心に全般的に下期の予想が慎重であった。装置関連は特に第3四半期が良かった。CMSはシリコンウエーハ加工の設備移管の遅れで売上が計画を下回ったが、オペレーションは順調 2. 売上総利益:装置関連、電子デバイスの売上高が計画を超過したことによる 3. 販管費:計画を上回る増収により販管費も計画超過 4. 営業外損益:為替相場の安定
売上原価	Cost of sales	7,046	27.2	7,057	27.4	0.2	
売上総利益	Gross profit	2,971	12.8	3,265	24.0	9.9	
販管費	SG&A expenses	2,385	17.1	2,567	26.1	7.6	
営業利益(A)	Operating Income	587	△ 2.0	699	16.7	19.1	
営業外損益	Other income & expense	△ 227	-	△ 183	-	-	
経常利益	Recurring income	360	304.5	516	479.8	43.3	
特別損益	Extraordinary gain & loss	△ 113	-	△ 36	-	-	
税前利益	Income before taxes	248	-	481	-	94.0	
法人税等	Income tax & others	87	-	305	-	250.6	
下期利益	Net income	162	-	175	-	8.0	

## 事業別差異 Operations in Business Segments

決算期 Accounting Period		05/3下期計画(A)		05/3下期実績(B)			コメント
		Original plan		Achievement			
製品	Product Lines	金額	前年同期比	金額	前年同期比	計画比	
		Mil.Yen	YOY	Mil.Yen	YOY	B/A	
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	1,848	10.7	2,162	29.5	17.0	1. 装置関連: 第3四半期以降の落ち込みを想定していたが、落ち込みは第4四半期以降だった。もっともFPDは国内メーカー中心に第4四半期以降も比較的堅調。シリコン製品は稼働、顧客開拓共に順調。 2. 電子デバイス: コンピュータシールは第4四半期の出荷増で計画超過。サーモモジュールは、自動車向けはほぼ計画線。半導体関連の落ち込みが少なかった。 3. CMS事業: シリコンウエーハ加工は移管遅れにより売上高が計画未達となったが、収益性改善は進む。工作機械製造、部品洗浄も顧客開拓進みセグメント全体の収益性改善は計画以上
石英製品	Quartz	1,825	26.6	2,206	53.0	20.9	
シリコン製品	Silicon products	501	16.0	603	39.6	20.4	
EB-ガン・その他	EB-Gun & Others	723	20.3	893	48.6	23.5	
装置関連	Equipment related	4,897	18.2	5,863	41.5	19.7	
コンピュータシール	Computer Seals	205	△ 71.2	315	△ 55.7	53.7	
サーモモジュール	Thermo-electric Modules	870	12.7	926	19.9	6.4	
磁性流体・その他	Ferrofluid & Others	254	△ 19.9	222	△ 30.0	△ 12.6	
電子デバイス	Electronic devices	1,328	△ 26.2	1,462	△ 18.8	10.1	
受託生産	CMS	3,792	70.0	2,997	28.6	△ 21.0	
売上高合計	Total Sales	10,017	22.5	10,321	26.2	3.0	



7. 連結損益計算書(計画) Consolidated Statements of Income (Estimated)

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	05/3		06/3e		前期比 YOY	06/上e	06/下e	コメント
		金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	構成比 Share		金額 Mil.Yen	金額 Mil.Yen	
売上高	Net Sales	21,105	100.0	22,400	100.0	6.1	10,100	12,300	前提為替レート 1ドル=105円 1. 売上高: 半導体向け落ち込むが、FPD向け堅調、英・独でのM&A効果もあり真空シールは横ばい、石英製品減少。サーモモジュールは自動車向けがシートへの組付けが始まり増収だが立ち上げで費用先行。CMSはウエーハ加工の設備移管が年度末に終了予定。工作機械、部品洗浄も 2. 粗利率: CMSの構成比上昇するが、引き続き同事業の収益性改善で粗利率低下は軽微 3. 販管費: 売上げ増加及び役職員の給与等復元に伴い増加 4. 営業外損益: 主に支払利息300百万円 5. 特別損失: 設備の更新による除却損、棚卸資産の廃棄損等の見込み
売上原価	Cost of sales	14,423	68.3	15,400	68.8	6.8	7,090	8,309	
売上総利益	Gross profit	6,682	31.7	7,000	31.3	4.8	3,010	3,990	
販管費	SG&A expense	4,920	23.3	5,200	23.2	5.7	2,670	2,530	
営業利益(A)	Operating income	1,762	8.3	1,800	8.0	2.2	340	1,460	
営業外損益	Other income	△ 306	△ 1.4	△ 300	△ 1.3	-	-	-	
経常利益	Recurring income	1,456	6.9	1,500	6.7	-	170	1,330	
特別利益	Extraordinary gain	212	1.0	-	-	-	-	-	
特別損失	Extraordinary losses	458	2.2	245	1.1	△ 46.5	-	-	
税引前利益	Income before income tax	1,210	5.7	1,254	5.6	3.6	1,084	1,254	
法人税等	Income tax & others	577	2.7	554	2.5	△ 4.0	-	-	
当期利益	Net income	633	3.0	700	3.1	-	90	610	

設備投資	Capital expenditures	2,073		3,000			主にCMS事業における新製品の製造を目的とした設備	
減価償却費(B)	Depreciation & amortization	1,359		1,400				
研究開発費	R&D expenses	109		200				
EBITDA(A+B)	Cash flows	3,121		3,200				

1株当たり利益(円)	EPS(yen)	35.15		41.15				
1株当たりEBITDA(円)	EBIDAPS(yen)	156.70		188.11				
1株当たり配当(単体、円)	DPS(yen)	8.00		8.00				
期末従業員数(人)	Number of employees	3,323		3,500				

\* 連単倍率 Consolidated/Non Consolidated ratio

	05/3			06/3e		
	単独(A) Non Consoli.	連結(B) Consoli.	連単倍率 (A)/(B)	単独(A) Non Consoli.	連結(B) Consoli.	連単倍率 (A)/(B)
売上高 Net Sales	8,927	21,105	2.4	11,300	22,400	2.0
営業利益 Operating Income	352	1,762	5.0	570	1,800	3.2
経常利益 Recurring income	645	1,456	2.3	860	1,500	1.7
当期利益 Net income	230	633	2.8	490	700	1.4

## 8. 連結キャッシュフロー Consolidated Statements of Cash Flows

(単位 百万円/Unit Mil.Yen)

Activities & Prime Item	04/3	05/3	コメント
税金等調整前利益 Income before income taxes	△ 559	1,210	
減価償却費 Depreciation and Amortization	1,180	1,359	
貸倒引当金の増減額 Changes in Allowance for doubtful receivables	37	152	
たな卸資産の増減額 Changes in Inventories	56	△ 180	
その他資産の増減額 Changes in Others	△ 43	△ 277	
その他 Others	455	△ 115	
<b>I. 営業活動によるキャッシュフロー Cash flows from operating activities</b>	<b>1,126</b>	<b>2,149</b>	
有形固定資産の取得による支出 Payments for purchase of tangible fixed assets	△ 1,632	△ 2,324	主な内訳: 杭州大和 1,166百万円 上海 667百万円 杭州日磁科技 153百万円
有形固定資産の売却による収入 Proceeds from sales of tangible fixed assets	34	383	Ferrotec (USA) Corporation(以下 FTU) 367百万円
営業譲受による支出 Payments for acquisition of goodwill	-	△ 323	競合企業であったアドバンス・フルイド・システム(英国)から営業権及び有形固定資産を取得(FTU)
投資有価証券の取得による支出 Payments for purchase of marketable securities and investments in securities	△ 295	△ 93	
投資有価証券の売却による収入 Proceeds from sales of marketable securities and investments in securities	200	304	フェローテックによる保有投資有価証券の売却
その他 Others	△ 536	△ 296	
<b>II. 投資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities</b>	<b>△ 2,229</b>	<b>△ 2,349</b>	
長期借入れによる収入 Proceeds from long-term dept	2,815	1,497	* 長期借入れの主な実績 フェローテック:800百万円 上海申和:484百万円
長期借入金の返済による支出 Payments of long-term dept	△ 2,542	△ 3,096	* 長期借入金の主な返済実績 フェローテック:2,021百万円 杭州大和:199百万円 上海申和:247百万円 FTU:394百万円
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 Proceeds from bonds with warrants	1,844	-	* 公募増資(オーバーアロットメント含) 発行新株式数 2,800千株 発行価格 741.39円
株式の発行による収入 Proceeds from capital issue	-	2,049	
その他 Others	△ 751	△ 177	
<b>III. 財務活動によるキャッシュフロー Cash flows from Financing activities</b>	<b>1,366</b>	<b>273</b>	
<b>IV. 現金及び現金等価物の期末残高 Cash &amp; Cash Equivalent</b>	<b>3,123</b>	<b>3,188</b>	

## 9. 主要製品の売上推移 Proceeds change of a main product

### (1) 売上高 Net Sales

(単位 百万円/Unit Mil.Yen)

決算期 Accounting Period		単体 Nonconsolidated			連結 Consolidated					
		99/3	00/3	01/3	01/3	02/3	03/3	04/3	05/3	06/3e
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	715	1,334	2,181	5,100	3,931	3,208	3,105	4,214	4,200
石英製品	Quartz	665	1,096	1,572	3,670	3,050	2,293	2,658	4,300	3,972
シリコン製品	Silicon products	—	—	—	—	—	—	821	1,100	1,271
EB-ガン・その他	EG-Gun&Others	—	—	—	1,503	2,134	1,349	1,338	1,589	1,807
<b>装置関連</b>	<b>Manufacturing Eqpt Related</b>	<b>1,380</b>	<b>2,430</b>	<b>3,753</b>	<b>10,273</b>	<b>9,115</b>	<b>6,851</b>	<b>7,921</b>	<b>11,203</b>	<b>11,250</b>
コンピュータシール	Computer Seals	3,086	2,587	2,585	2,585	2,209	1,585	1,363	1,012	158
サーモモジュール	Thermo-electric Modules	305	410	591	1,150	893	1,110	1,577	2,054	2,222
ハードディスク関連	HDD products	179	502	828	880	467	332	—	—	—
磁性流体・その他	Ferro Fluid&Others	208	385	966	1,547	1,421	1,243	680	512	522
<b>電子デバイス</b>	<b>Electric devices</b>	<b>3,778</b>	<b>3,884</b>	<b>4,970</b>	<b>6,162</b>	<b>4,990</b>	<b>4,270</b>	<b>3,619</b>	<b>3,578</b>	<b>2,902</b>
受託生産	CMS	—	—	—	—	670	1,722	3,458	6,325	8,248
<b>売上高合計</b>	<b>Total Sales</b>	<b>5,158</b>	<b>6,314</b>	<b>8,723</b>	<b>16,435</b>	<b>14,775</b>	<b>12,845</b>	<b>15,000</b>	<b>21,105</b>	<b>22,400</b>

\* 受託生産(CMS)は03/3期から決算短信等で独立表示しております。

### (2) 前期比 Growth Rate

(単位 %)

決算期 Accounting Period		単体 Nonconsolidated			連結 Consolidated					
		99/3	00/3	01/3	01/3	02/3	03/3	04/3	05/3	06/3e
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	△ 34.7	86.6	63.5	—	△ 22.9	△ 18.4	△ 3.2	35.7	△ 0.3
石英製品	Quartz	—	—	43.4	—	△ 16.9	△ 24.8	15.9	61.8	△ 7.6
シリコン製品	Silicon products	—	—	—	—	—	—	—	34.0	15.5
EB-ガン・その他	EG-Gun&Others	—	—	—	—	42.0	△ 36.8	△ 0.8	18.8	13.7
<b>装置関連</b>	<b>Manufacturing Eqpt Related</b>	<b>26.0</b>	<b>76.1</b>	<b>54.4</b>	<b>—</b>	<b>△ 11.3</b>	<b>△ 24.8</b>	<b>15.6</b>	<b>41.4</b>	<b>0.4</b>
コンピュータシール	Computer Seals	39.6	△ 16.2	△ 0.1	—	△ 14.5	△ 28.2	△ 14.0	△ 25.8	△ 84.4
サーモモジュール	Thermo-electric Modules	△ 25.6	34.4	44.1	—	△ 22.3	24.3	42.1	30.2	8.2
ハードディスク関連	HDD products	△ 62.8	180.4	65.0	—	△ 46.9	△ 28.9	—	—	—
磁性流体・その他	Ferro Fluid&Others	△ 54.9	85.1	150.8	—	△ 8.1	△ 12.5	△ 45.3	△ 24.7	2.0
<b>電子デバイス</b>	<b>Electric devices</b>	<b>6.0</b>	<b>2.8</b>	<b>28.0</b>	<b>—</b>	<b>△ 19.0</b>	<b>△ 14.4</b>	<b>△ 15.2</b>	<b>△ 1.1</b>	<b>△ 18.9</b>
受託生産	CMS	—	—	—	—	—	—	100.8	82.9	30.4
<b>売上高合計</b>	<b>Total Sales</b>	<b>10.7</b>	<b>22.4</b>	<b>38.2</b>	<b>—</b>	<b>△ 10.1</b>	<b>△ 13.1</b>	<b>16.8</b>	<b>40.7</b>	<b>6.1</b>

### (3) 構成比 Share

(単位 %)

決算期 Accounting Period		単体 Nonconsolidated			連結 Consolidated					
		99/3	00/3	01/3	01/3	02/3	03/3	04/3	05/3	06/3e
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	13.9	21.1	25.0	31.0	26.6	25.0	20.7	20.0	18.8
石英製品	Quartz	—	17.4	18.0	22.3	20.6	17.9	17.7	20.4	17.7
シリコン製品	Silicon products	—	—	—	—	—	—	5.5	5.2	5.7
EB-ガン・その他	EG-Gun&Others	—	—	—	—	14.4	10.5	8.9	7.5	8.1
<b>装置関連</b>	<b>Manufacturing Eqpt Related</b>	<b>—</b>	<b>38.5</b>	<b>43.0</b>	<b>62.5</b>	<b>61.7</b>	<b>53.3</b>	<b>52.8</b>	<b>53.1</b>	<b>50.2</b>
コンピュータシール	Computer Seals	59.8	41.0	29.6	15.7	15.0	12.3	9.1	4.8	0.7
サーモモジュール	Thermo-electric Modules	5.9	6.5	6.8	7.0	6.0	8.6	10.5	9.7	9.9
ハードディスク関連	HDD products	3.5	7.9	9.5	5.4	3.2	2.6	—	—	—
磁性流体・その他	Ferro Fluid&Others	4.0	6.1	11.1	9.4	9.6	9.7	4.5	2.4	2.3
<b>電子デバイス</b>	<b>Electric devices</b>	<b>73.2</b>	<b>61.5</b>	<b>57.0</b>	<b>37.5</b>	<b>33.8</b>	<b>33.2</b>	<b>24.1</b>	<b>17.0</b>	<b>13.0</b>
受託生産	CMS	—	—	—	—	—	13.4	23.1	30.0	36.8
<b>売上高合計</b>	<b>Total Sales</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>